

Plaskon SMT-B-2FPI

Epoxy; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

Описание материалов:

This material is an epoxy molding compound for high temperature, lead-free reflow in fine pitch applications. It is designed to withstand more demanding requirements in moisture performance, occasioned by the higher IR reflow temperatures required for processing lead-free packages. It is a highly filled, multifunctional resin designed to pass JEDEC Level 3 at 240°C IR reflow temperatures.

Главная Информация			
Характеристики	Полупроводникового Низкое (до по) Содержание свинца Низкая гигроскопичность Ускоренная Настройка Хорошая производительность формования Теплостойкость, высокая		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.88	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль			ASTM D790
22°C	1.37	MPa	ASTM D790
240°C	0.147	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			ASTM D790
22°C	0.00981	MPa	ASTM D790
240°C	0.00196	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	210	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	1.7E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.70	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	16	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 kHz)	4.00		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.18 mm)	V-0		UL 94
Дополнительная информация			

Recommended Storage Temperature: <5°C Life @ 5°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 24 months Life @ 22°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 8 days Life @ 35°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 3 days Spiral Flow, 175°C, 1000 psi: 140 cm Shimadzu Viscosity, 175°C, 1000 psi: 65 poise Ram Follower Gel Time, 175°C, 1000 psi: 20 sec Ash Content: 80 % Hydrolyzable Halides: <1 ppm Moisture Absorption, 85°C/85%RH, 168 hrs: 0.51% Cull Hot Hardness, Shore D: 80 Volume Resistivity, 22°C: 1e15 ohm-cm Volume Resistivity, 150°C: 1e12 ohm-cm All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 17 cm⁻⁶/cm/°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 55 cm⁻⁶/cm/°C

Инструкции по впрыску

Resin Transfer Molding:

Molding Temperature: 170 to 185°C

Molding Pressure: 750 to 1250 psi

In Mold Cure Time: 70 to 120 sec

Post Mold Cure Time, 175°C: 0 to 3 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat